

1-2-2-10 基板銅めっき面薬液食れ／镀铜面被药液腐蚀 / Etched copper of base material

【特徴】 基板銅めっき表面が食われて凹んでいる状態の欠陥

【特征】 板件的镀铜面被腐蚀而凹陷的缺陷。

【Characteristics】 Plated copper surface of the base material is etched and depressed.

【原因・判断ポイント・発生工程】 基板の D F R ラミネート前研磨面が薬液の滴下により食われて出来たもの（D F R ラミネート前研磨直後）

【原因、判断要点、发生工序】 板件在 DFR 前，研磨面受药水滴液腐蚀所引起的（DFR 压合前至研磨后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Drops of a chemical solution on the abraded copper surface of the base material prior to dry film lamination erode the surface. (Just after scrubbing prior to dry film lamination)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-2-2-11 大径穴周り引掛け欠け／大径孔周围拉裂的缺口 / Nick by tearing around large hole

【特徴】 大径穴の周りに多く見られる、銅箔剥がれ状の欠け

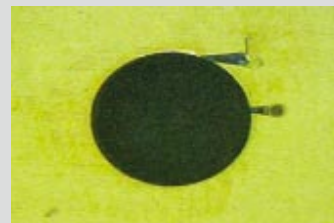
【特征】 在大径孔周围常见的铜箔剥离形状的缺口。

【Characteristics】 A nick of the form of torn off copper foil is often seen around a large sized hole

【原因・判断ポイント・発生工程】 穴あけ加工後のプリント配線板搬送中に、穴バリが相互に引っかかって出来たもの（穴あけ工程後～D F R ラミネート前）

【原因、判断要点、发生工序】 在搬运钻孔后的板件过程，孔的披锋互相拉扯而引起的（钻孔工序后～DFR 压合前）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Burrs around a drilled hole of a stacked multiple panel are seized each other during transportation causing the defects. (Drilling process - dry film lamination process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×